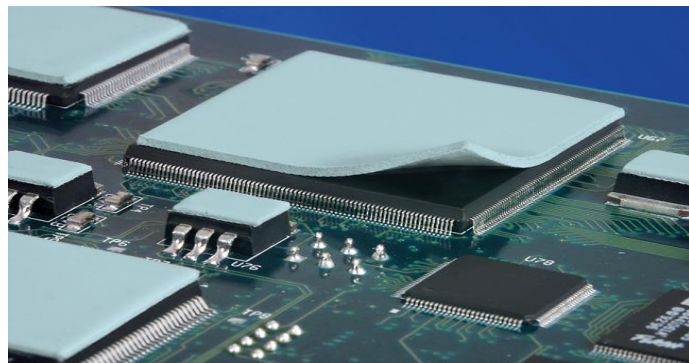
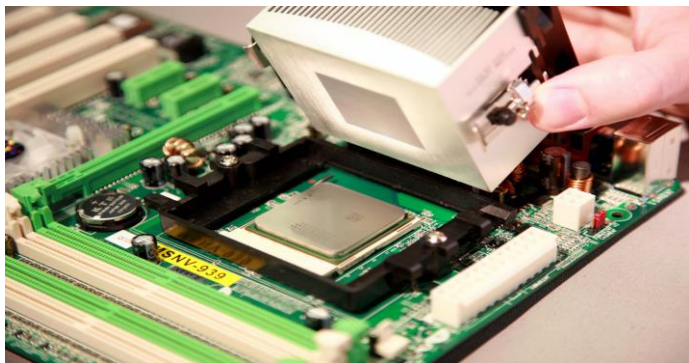


导热硅胶片具有优异的导热性和电气绝缘性，能满足大部分电子产品导热绝缘要求，是专门为利用缝隙传递热量的设计方案制作，能够填充缝隙，有效的将发热部件的热量传递到散热器上；同时本产品又具有粘性，应用简单方便。硅胶片利用软性硅胶导热材料稳定的导热、绝缘性能以及柔软而富有弹性等特点，置于发热器件与散热部件之间，达到传热和绝缘的效果。



### 典型应用：

存储设备、LED灯饰、照明设备、家用电器、LCD显示器、半导体与散热片之间、通信产品、智能手机、平板电脑、台式电脑、安防设备、大功率电源等。

### 性能及特点：

产品性能稳定、低阻热、有效的提高热能传递速度、导热性能选择性多、自身黏性度高、易于粘接使用、回弹性好、长

期使用可靠性能高、多种厚度选择、应用广泛。

### 产品规格说明：

- ◆ 产品标准尺寸330mm\*330mm、可根据客户需要裁切冲型。
- ◆ 基本厚度 0.5mm~5mm 其余特殊尺寸、厚度可订做。
- ◆ 产品本身具有微粘性、若需要加强粘性可根据需要背胶。
- ◆ 产品颜色为量产颜色、如需要特殊颜色可根据实际情况调整。

产品型号	PM200	Test Method
颜色	灰白 蓝色 浅灰	Visual
主要成份	矽胶	***
厚度(inch/mm)	0.020 to 0.800(inch) 0.508 to 20(mm)	ASTM D751
密度 (g/cc)	2.2	ASTM D297
硬度 (Shore 00)	68	ASTM D2240
拉伸强度 (psi)	15	ASTM D412
使用温度,(°F/°C)	(-58 to 392 °F) (-58 to 200 °C)	***
电学性		
击穿电压 (V)	>3000(Thickness≤0.5mm) >5000(Thickness≥0.5mm")	ASTM D149
介电常数 (1M HZ)	15.0	ASTM D150
体积电阻率 (Ohm.cm)	10 <sup>13</sup>	ASTM D257
防火等级	94 V0	Equivalent UL
导热性		
导热系数(W/m-K)	2.0	ASTM D5470
可玻纤加强	任何厚度均可玻纤加强，以 FG 为后缀标示	